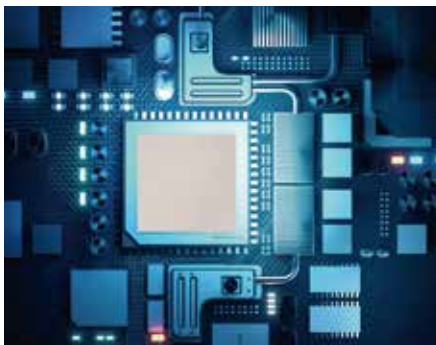


Fill-Pad UT600导热垫片

产品描述



泰吉诺的导热垫片Fill-Pad UT600是一款陶瓷填充非硅有机聚合物的垫片，导热系数为6.0W/m-K，是专门为超低厚度应用场景开发的一款超薄垫片。独特的配方设计使其有良好的界面润湿性，导热性及优秀的力学特性，可适用于多种应用环境，不会因为压力和温度的波动而失效。此款垫片具有低挥发、低渗油等特性，不含有有机硅小分子，尤其适用于对硅氧烷挥发物敏感的电子应用领域。

产品特点

- ◆ 导热系数6.0W/m-K
- ◆ 良好的表面润湿性可以充分降低接触热阻
- ◆ 非硅体系，无硅污染
- ◆ 低渗油，低挥发
- ◆ 高可靠性
- ◆ 有低残余应力，有较强的自修复能力
- ◆ 高绝缘强度

典型应用

- ◆ IGBT
- ◆ 5G通信基站、无线基础设施、光模块
- ◆ LCD、PDP和激光电视显示器
- ◆ 工业、LED照明及电源模块
- ◆ 硬盘驱动器及固态硬盘存储设备
- ◆ 发热元器件与散热器或壳体之间散热

技术参数

性能参数	Fill-Pad UT600	测试方法
基本特性		
结构	陶瓷粉填充非硅聚合物	N/A
颜色	浅灰色	目视
厚度范围 (mm)	0.2~0.5	N/A
密度 (g/cm³)	3.1	ASTMD792
硬度(Shore00)	70	ASTMD2240
挥发物 TML(%)	0.20	ASTME595
挥发物 CVC(%)	0.04	ASTME595
工作温度(°C)	-40~ 125	泰吉诺实验室
导热性能		
导热系数 (W/m-K)	6.0	ASTMD5470
热阻 (°C·in²/W) (0.2mm@10psi)	0.05	ASTMD5470
电学性能		
介电常数@1MHz	8.1	ASTMD150
介电强度 (KV/mm)	≥ 7	ASTMD149
体积电阻率 (ohm-cm)	1.0×10¹⁴	ASTMD257
阻燃等级		
阻燃等级	V-0	UL94

注：本资料中数据皆为测试典型值，结果仅供参考，不可作为产品性能指标使用

注意事项

- ◆ 切勿食用
- ◆ 避开儿童可触及的地方保管
- ◆ 产品放置须远离火源
- ◆ 请确认使用的正确性之后再使用
- ◆ 注意不要让涂布面沾上异物和灰尘

保存及寿命

- ◆ 产品需在0-35°C，不超过65%相对湿度环境下密封保存
- ◆ 保质期自包装之日起12个月

订购信息

- ◆ 厚度标称值± 0.1mm，厚度可以根据客户要求定制。订购前请详询可用厚度

